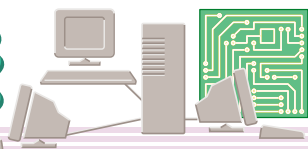


香港の新しい活用法

～香港サイエンスパーク～



BY HONGKONG OFFICE

先進国を中心に“知識集約型経済への転換”が進む中、「世界の工場」として飛躍的な成長を続けている中国でも、技術革新を牽引力として一気に転換のスピードアップを図ろうと本腰を入れて取り組んでいます。

97年に中国に返還された香港でも、返還前に培われた法制度などを生かしながら、知識集約型都市を目指すことを重要施策の一つとして掲げ、ハイテクノロジー分野への関心が高まる中国、とりわけ華南地域の生産基地との連携により香港の新たな強みを創出しています。今回はこの事業の中核となる香港サイエンスパークについてレポートします。



1. 香港サイエンスパークの概要

香港サイエンスパークは、香港特別行政区政府が15億米ドル(約1,650億円)を投じて香港新界地区沙田に建設している研究開発(R&D)センターです。IT・電気通信、エレクトロニクス、精密工学、バイオテクノロジーの4分野での技術革新を促し、関連企業の研究開発に最適な環境を提供すると共に入居企業および香港と中国との架け橋になることを目的として設立されました。

工期は3期に分かれており、第1期分は04年10月に既に完成しています。残りはそれぞれ第2期分が06年、第3期分が11年に完成する予定で、完成後の総面積は約33万平方メートルにのびります。ちなみに建設資金は政府が出資していますが、運営は民間企業である香港科技园公司が行なっています。第一期分(4月末現在)の契約率は約95%(入居率80%)で、オムロンなど5社の日系企業も既に入居しています。



香港サイエンスパーク完成予想図 (PHASE 3は2011年完成予定)

入居基準は、テクノロジー集約事業者であることや主な事業が大量生産ではないこと、環境に優しい事業であることなど、同パークの設立目的に沿った形で決められています。

サイエンスパークの大きな特徴の一つは、資金力の乏しい中小・ベンチャー企業でも大企業と同様の環境で研究・開発が行なえる共用施設が準備されていることです。例えば、ICをデザインする際に必要な最新の計測機器や装置、ソフトウェアなどをレンタルできるため設備投資資金がかかりませんし、ビジネスの立ち上げ期間も短くできます。共用ということで入退室や情報漏えいに対するセキュリティが気になるところですが、こうした機密保持に関しては万全の対策が施されています。



フォトニクスセンター／ワイヤレスセンター

また、法整備がしっかりしている香港では知的財産権が保護されているため、この点を重視してサイエンスパークに進出している外資企業もあります。コスト面では操業コストが中国に比べて2割前後割高になりますが、中には創業時からの製造ノウハウを守るために同パークに入居した中国企業もあるほどです。

人材育成面でも、大学生の短期採用や大型プロジェクトへの参加、高度な技術を有する海外の人材との交換トレーニー制度などが設けられており、今後この分野で予想される人材不足への対応にも積極的に取り組んでいます。

さらに、香港の産業界に貢献すると考えられる研究開発には発明・技術基金から資金援助が行なわれるそうです。

2. 中国との連携

中国には、北京・上海・深圳・西安・杭州・無錫・成都に7つのIC設計拠点があり、香港と「7+1」協力協定(本土7ヶ所と香港との協力協定)を締結しています。

これらの拠点は、香港サイエンスパークのICデザインセンターの指導によってIC設計分野での香港と中国本土の国際競争力向上に向けた活動をしています。また、この協定には同パークのICデザイン・開発支援センターを介した情報交換・人事交流・合同研修プログラムをはじめとする幅広い分野における資源の共有と協力も含まれています。

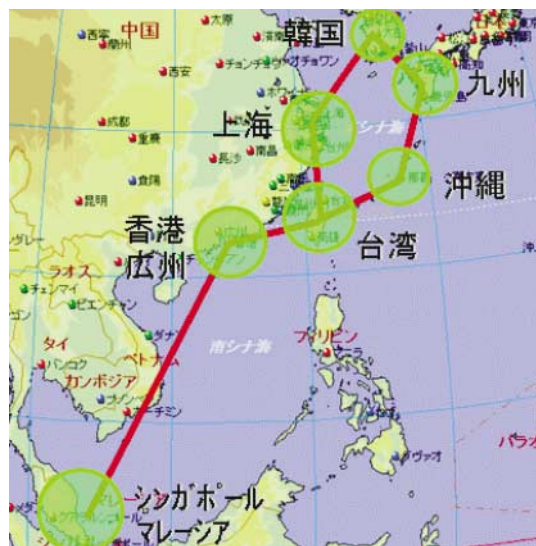
前述のとおり同パークでは人材育成にも力を入れています。こうした協力関係を活用して中国本土からも優秀な人材を広く集めています。本土のエンジニアたちも香港に7年以上住めば永久居民になれることや個人所得税率が低いことなどを理由に香港での就業に前向きなようです。

3. アジアとの連携

ところで、香港や中国の他にも日本・韓国・台湾などアジアの各地域でも半導体設計・製造の知的集積、産業集積が行なわれています。

日本でも各国との連携を目指す動きがあり、福岡県では「シリコン・シー・ベルト

構想」を提唱しています。これは、海で結ばれたアジア各国・地域を「シリコン・シー・ベルト」と呼び、世界の半導体の設計・開発・製造の拠点とすることを指すものです。その推進の一環として、シリコン・シー・ベルト各国・地域が問題意識を共有し、人的ネットワークを強め、21世紀の世界のシステムLSIに関する情報発信の拠点とすべく03年から毎年『シリコン・シー・ベルト・サミット』が開催されています。また、去年の第二回サミットでは、香港・上海・新竹(台湾)・京畿道(韓国)・福岡5地域の半導体関連団体による『シリコン・シー・ベルト(SSB)代表委員会』の結成に向けて活動を続けていくことが合意されました。



シリコン・シー・ベルト
 ((財)福岡県産業・科学技術振興財団HPより転載)

今後は、こうした活動の中で地域間格差を補うための人材交流や施設の共有などが進むと共に、それぞれの地域が切磋琢磨して関連企業にとってより良い環境が形成されていくことが期待されます。

4. 終わりに

今回の取材に当たり香港サイエンスパークを訪問し、いくつかの施設も見学しましたが、クリーンルームなどに置かれた共用機器の中には一台で数億円もするものがあると聞いて驚きました。また、それぞれの分野のテナント企業は各センター内に『常設展示場』を設け、製品や研究成果などについてわかりやすく説明しており、平日には学生に、また休日には一般にも公開しています。こうした機会に触れた学生の方々の中から将来の優秀なエンジニアが生まれることを祈ってやみません。

ところで、香港科技园公司是サイエンスパークの他にも香港内3ヶ所に工業団地を保有しています。したがって、研究開発はサイエンスパークで行い新製品をすぐ近くにある工業団地で製造することも可能です。もちろんコスト面では本土の方が安いので、製品化は本土で行なうという手もあります。昔から中国への戦略的な出入り口として利用されてきた香港の利点はここでも生きてくる訳です。

《連絡先》

日本：香港科技园公司 日本代表 馮麗萍 (フォン リーピン)
 〒103-0007 東京都中央区浜町3-35-5
 電話：03-5652-9983 FAX：03-5652-9985
 香港：香港科技园公司 総辦事所 副總裁 羅肇強
 香港新界沙田香港科学園科技大道西2号
 電話：852-2629-1818 FAX：852-2664-2481